

東洋紡エムシー株式会社

本 社 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 東京支社 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目 17番 10号

2025年11月4日

「productronica 2025」に低圧成形封止材「バイロショット®」を出展します

東洋紡エムシー株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長執行役員CEO:森重 地加男、以下「当社」)は、 東洋紡STC株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長:奥田 有史、以下「東洋紡STC」)とともに、2025年11月 18日(火)~21日(金)にドイツ・ミュンヘンで開催される「productronica 2025」に出展します。当社は、車載やFA機器 等の電子部品、センサーなどの封止に使用される低圧成形封止材「バイロショット®」を展示いたします。

「productronica 2025」は、世界有数のエレクトロニクス分野の展示会です。5つのゾーンで構成され、当社は「PCB & EMS Cluster」ゾーンに出展いたします。

「バイロショット[®]」は、プリント基板や電子部品の保護が可能な低圧成形封止材で、電子分野、自動車分野などで防水、防塵のための封止材として使用されます。流動性が高く、低い圧力で成形できるため電子部品への負荷を抑制できます。また、冷却・硬化時間が短いため、従来の2液硬化系樹脂と比較して、生産性が大幅に向上します。



「バイロショット®」で封止した成形品

展示ブースでは、「バイロショット®」を用いて封止した成形品を展示し、柔軟性・薄肉成形性・流動性・長期耐久性などの特長をアピールします。

1. 出展する製品

● 低圧成形封止材「バイロショット®」

2. 「productronica 2025」について

会期 :2025年11月18日(火)~21日(金)9:00~18:00(最終日のみ16:00まで)

● 会場 :ドイツ・ミュンヘン見本市会場

● ブース番号:B3.376(東洋紡 STC ブースに出展)

● 主催 :Messe Muenchen GmbH — メッセ・ミュンヘン

• URL :productronica 2025

以上

このニュースリリースに掲載されている内容は、発表日時点の情報です。 発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

■お問い合わせ先

東洋紡エムシー株式会社 経営企画部 企画・広報グループ Mail:info_tmc@toyobo-mc.jp Tel:06-6348-3310